

## ハードウェアセキュリティ(HWS)研究会【開催案内】

### 【概要】

日時：2018年3月2日(金), 3月3日(土)

3月2日(金)は電子情報通信学会 VLSI 設計技術研究会(IEICE-VLD)と共催

3月3日(土)は電子情報通信学会ハードウェアセキュリティ特別研究専門委員会(IEICE-HWS)主催

会場：3月2日(金)：沖縄県青年会館、3月3日(土)：沖縄県青年会館 2F 会議室

研究会参加費：3月2日：無料、3月3日：参加費 2,000 円

懇親会：3月2日 セッション終了後 懇親会を予定：詳細は別途連絡

募集要項：ハードウェアセキュリティ技術全般のご発表

【発表申し込み・1】：3月2日は VLD の研究会発表申し込みシステム

<http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgid=IEICE-VLD>

から（題目、著者、所属、アブストラクト等）お申し込みください。（申し込みの際に HWS での発表と明記ください）

●発表申込期限：2018年1月15日（月）

●原稿提出期限：2017年2月初旬

●原稿ページ数：6ページ以内

【発表申し込み・2】：3月3日は HWS の研究会発表申し込みシステム

<http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgid=IEICE-HWS>

から（題目、著者、所属、アブストラクト等）お申し込みください。

●発表申込期限：2018年1月29日（月）

●原稿なし

【講演時間】 20分+質疑5分

※発表申し込み多数の場合は受付順に幹事団および担当にて選定いたします。

※3月3日分に関しては論文投稿受付を行わないため研究技報にも掲載はされません。

題目、著者、アブストラクトが Web 掲載されます。詳細内容の公開を希望する際は  
ご相談ください。

### 【問い合わせ】

研究会担当：池田誠（東京大学）： [iked@silicon.u-tokyo.ac.jp](mailto:iked@silicon.u-tokyo.ac.jp)